

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年10月26日
【会社名】	株式会社三社電機製作所
【英訳名】	Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 四方 邦夫
【本店の所在の場所】	大阪市東淀川区西淡路三丁目 1 番56号
【電話番号】	大阪(06)6321-0321(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 佐藤 光
【最寄りの連絡場所】	大阪市東淀川区西淡路三丁目 1 番56号
【電話番号】	大阪(06)6321-0321(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 佐藤 光
【縦覧に供する場所】	株式会社三社電機製作所 東京支店 (東京都台東区東上野一丁目28番12号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年10月26日開催の取締役会において、株式会社三社エンジニアリングサービスとの合併に関する基本合意書を、当社及び株式会社三社エンジニアリングサービスとの間で締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該吸収合併の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社三社エンジニアリングサービス
本店の所在地	大阪市東淀川区西淡路四丁目24番7号
代表者の氏名	代表取締役社長 本多 宏彰
資本金の額	20百万円
純資産の額	705百万円
総資産の額	959百万円
事業の内容	電気機械器具の修理、保守点検、設置工事及び電気配線工事

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

事業年度	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上高(百万円)	1,383	1,522	1,458
営業利益(百万円)	223	195	135
経常利益(百万円)	225	196	136
当期純利益(百万円)	131	112	60

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社三社電機製作所	100.00

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、株式会社三社エンジニアリングサービスの発行済株式総数の全てを保有しております。
人的関係	当社の取締役3名が株式会社三社エンジニアリングサービスの取締役を兼務しており、あわせて、当社の監査役1名が株式会社三社エンジニアリングサービスの監査役を兼務しております。
取引関係	当社製品の販売、設置工事、保守点検等の取引関係があります。

(2) 当該吸収合併の目的

株式会社三社エンジニアリングサービスは、当社の100%出資の連結子会社として、当社が製造販売した各種電源機器の据付試運転及び保守点検を中心としたアフターサービス事業を行ってまいりましたが、当社の営業部門と一体運営することにより、お客様満足度の向上を推進するとともに、業務の効率化とコーポレート・ガバナンスの強化を図ります。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

当該吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社三社エンジニアリングサービスは本合併により解散する予定です。

吸収合併に係る割当ての内容

株式会社三社エンジニアリングサービスは、当社の100%出資する連結子会社であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いはありません。

その他の吸収合併契約の内容

基本合意書締結取締役会 平成24年10月26日

基本合意書締結日 平成24年10月26日

合併契約書締結取締役会 平成25年1月(予定)

合併契約書締結日 平成25年1月(予定)

合併期日(効力発生日) 平成25年4月1日(予定)

なお、今後、合併手続きを進める中で、合併の実行に支障を伴う重大な事由が生じた場合には、両社協議の上、日程、手続、条件等を変更する場合があります。

(4) 当該吸収合併に係る割当ての内容の参考根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社三社電機製作所
本店の所在地	大阪市東淀川区西淡路三丁目1番56号
代表者の氏名	代表取締役社長 四方 邦夫
資本金の額	2,264百万円(本合併に伴う、資本金の額の変更はありません。)
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	半導体素子、電源機器の製造及び販売

なお、当該合併に必要な事項は、今後両社協議のうえ決定し、合併契約書の締結次第、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

以上